日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。 This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年 6月23日 出願番号 Application Number: [JP2003-177697] 出願人 ウムバマ たったたたけ

Applicant(s): 富士ゼロックス株式会社



2004年 1月 9日 特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

【書類名】	特許願	
【整理番号】	FE03-00626	
【提出日】	平成15年 6月23日	
【あて先】	特許庁長官殿	
【国際特許分類】	G01R 31/00	
【発明者】		
【住所又は居所】	神奈川県足柄上郡中井町境430	グリーンテクなかい
	富士ゼロックス株式会社内	
【氏名】	中川英悟	
【発明者】		
【住所又は居所】	神奈川県足柄上郡中井町境430	グリーンテクなかい
	富士ゼロックス株式会社内	
【氏名】	足立 康二	
【発明者】		
【住所又は居所】	神奈川県足柄上郡中井町境430	グリーンテクなかい
	富士ゼロックス株式会社内	
【氏名】	安川 薫	
【発明者】		
【住所又は居所】	神奈川県足柄上郡中井町境430	グリーンテクなかい
	富士ゼロックス株式会社内	
【氏名】	山田紀一	
【発明者】		
【住所又は居所】	神奈川県足柄上郡中井町境430	グリーンテクなかい
	富士ゼロックス株式会社内	
【氏名】	上床 弘毅	
【発明者】		
【住所又は居所】	神奈川県足柄上郡中井町境430	グリーンテクなかい
	富士ゼロックス株式会社内	

【氏名】 里永 哲一

•

•

ς.

【特許出願人】

【識別番号】	000005496
【氏名又は名称】	富士ゼロックス株式会社

【代理人】

-

【識別番号】	100086298
【弁理士】	
【氏名又は名称】	船橋 國則
【電話番号】	046-228-9850
【先の出願に基づく優先	6権主張】
【出願番号】	特願2002-367791
【出願日】	平成14年12月19日
【手数料の表示】	
【予納台帳番号】	007364
【納付金額】	21,000円
【提出物件の目録】	
【物件名】	明細書 1
【物件名】	図面 1
【物件名】	要約書 1
【包括委任状番号】	9507100
【プルーフの要否】	要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 回路基板検査装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定の部品や配線が形成されて成る回路基板の動作を検査する回路基板検査装置において、

前記回路基板の部品実装面と略平行に配置される支持基板と、

前記支持基板が前記回路基板と略平行に配置された状態で、前記支持基板にお ける前記回路基板の部品もしくは配線と対応する位置に配置される信号変化検出 手段と

を備えることを特徴とする回路基板検査装置。

【請求項2】 前記信号変化検出手段は、前記部品を流れる電流から発生す る磁界によって誘導起電力を発生するコイルを有する

ことを特徴とする請求項1記載の回路基板検査装置。

【請求項3】 前記信号変化検出手段は、前記配線を流れる信号変化によっ て電位情報を生じさせるインピーダンス成分を有する

ことを特徴とする請求項1記載の回路基板検査装置。

【請求項4】 前記支持基板は可撓性を有する薄型基板から成る ことを特徴とする請求項1記載の回路基板検査装置。

【請求項5】 前記支持基板は、前記回路基板とほぼ同じ大きさから成る ことを特徴とする請求項1記載の回路基板検査装置。

【請求項6】 前記支持基板が前記回路基板と略平行に配置された状態で、 前記支持基板における前記回路基板の所定の部品の位置と対応する位置に、前記 部品との接触を回避する孔が形成されている

ことを特徴とする請求項1記載の回路基板検査装置。

【請求項7】 前記支持基板は箱体に組立自在に設けられており、箱体に組 み立てた状態では前記回路基板を囲むよう配置される

ことを特徴とする請求項1記載の回路基板検査装置。

【請求項8】 前記コイルは、前記回路基板の外周に対応するよう前記支持 基板に巻回されている

ことを特徴とする請求項2記載の回路基板検査装置。

【請求項9】 前記コイルは、前記部品の外周に対応するよう前記支持基板 に巻回されている

ことを特徴とする請求項2記載の回路基板検査装置。

【請求項10】 前記コイルは、前記部品の端子の位置に対応するよう前記 支持基板に巻回されている

ことを特徴とする請求項2記載の回路基板検査装置。

【請求項11】 前記コイルは、前記回路基板の入出力コネクタの位置に対応するよう前記支持基板に巻回されている

ことを特徴とする請求項2記載の回路基板検査装置。

【請求項12】 前記コイルは、前記回路基板が複数ある場合の回路基板間 を接続するケーブルの位置に対応するよう前記支持基板に巻回されている

ことを特徴とする請求項2記載の回路基板検査装置。

【請求項13】 前記コイルは、前記回路基板が複数接続されてなる回路基 板群の外周に対応するよう前記支持基板に巻回されている

ことを特徴とする請求項2記載の回路基板検査装置。

【請求項14】 前記インピーダンス成分は容量成分で構成されている

ことを特徴とする請求項3記載の回路基板検査装置。

【請求項15】 前記インピーダンス成分はインダクタンス成分で構成されている

ことを特徴とする請求項3記載の回路基板検査装置。

【請求項16】 前記インピーダンス成分は抵抗成分で構成されている ことを特徴とする請求項3記載の回路基板検査装置。

【請求項17】 前記インピーダンス成分は、前記回路基板の配線と方向と 略直交するよう前記支持基板に配置されている

ことを特徴とする請求項3記載の回路基板検査装置。

【請求項18】 前記信号変化検出手段は、前記支持基板の複数層に跨って 配置されている

ことを特徴とする請求項1記載の回路基板検査装置。

【請求項19】 前記コイルは、前記支持基板の複数層の各々に均等な巻線 数で跨って形成されている

ことを特徴とする請求項2記載の回路基板検査装置。

【請求項20】 前記容量成分は、前記支持基板の複数層のうち2つに設け られた電極から構成されている

ことを特徴とする請求項14記載の回路基板検査装置。

【請求項21】 前記信号変化検出手段が複数設けられている場合、各信号 変化検出手段の片方の端子を共通で接続する

ことを特徴とする請求項1記載の回路基板検査装置。

【請求項22】 前記各信号変化検出手段の片方の端子を共通するにあたり 、その共通の端子を前記支持基板の外部で接地する

ことを特徴とする請求項21記載の回路基板検査装置。

【請求項23】 前記各信号変化検出手段の片方の端子を共通するにあたり 、前記支持基板の端部で共通接続する

ことを特徴とする請求項21記載の回路基板検査装置。

【請求項24】 前記信号変化検出手段が複数設けられている場合、各信号 変化検出手段の端子を接近させた状態で略平行にして前記支持基板に引き回す

ことを特徴とする請求項1記載の回路基板検査装置。

【請求項25】 前記支持基板は、前記回路基板の表側に配置される表側支 持基板と、前記回路基板の裏側に配置される裏側支持基板とから構成され、

前記表側支持基板には、前記回路基板の表側に実装される部品もしくは配線と対応する位置に前記信号変化検出手段が設けられ、

前記裏側支持基板には、前記回路基板の裏側に実装される部品もしくは配線と 対応する位置に前記信号変化検出手段が設けられている

ことを特徴とする請求項1記載の回路基板検査装置。

【請求項26】 前記支持基板は、前記回路基板の表側に配置される表側支 持基板と、前記回路基板の裏側に配置される裏側支持基板とから構成され、

前記信号変化検出手段は、前記表側支持基板と前記裏側支持基板との各々にま たがって形成されている ことを特徴とする請求項1記載の回路基板検査装置。

【請求項27】 前記支持基板は、前記回路基板の表側に配置される表側支 持基板と、前記回路基板の裏側に配置される裏側支持基板とから構成され、

前記表側支持基板と前記裏側支持基板とが一体的に形成されている

ことを特徴とする請求項1記載の回路基板検査装置。

【請求項28】 前記信号変化検出手段は、前記表側支持基板および前記裏 側支持基板のうち前記回路基板の検査対象となる部品もしくは配線が配置されて いる側に対応する方のみに設けられている

ことを特徴とする請求項26~27記載のうちいずれか1項に記載の回路基板 検査装置。

【請求項29】 前記信号変化検出手段で検出した信号と、予め記憶された 正常時の信号とを比較する信号照合部と、

前記信号照合部での比較結果に基づき検査対象部位が正常動作しているか否か を診断する診断部とを備える

ことを特徴とする請求項1記載の回路基板検査装置。

【請求項30】 前記信号照合部および前記診断部のうちいずれか、もしく は全てが前記支持基板に設けられている

ことを特徴とする請求項29記載の回路基板検査装置。

【請求項31】 前記信号照合部および前記診断部は、前記支持基板の外部 に設けられている

ことを特徴とする請求項29記載の回路基板検査装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、電子回路の異常、故障状態の検出、診断を行う装置に関し、例えば PWBAと称する複数の回路基板が接続されて形成される電子回路で構成されて いる機器において、電子回路の動作、性能の異常、故障を予測、検出し、あるい は予防する回路基板検査装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

パーソナルコンピュータ、複写機等の電子機器には、近年、性能、機能の向上 に伴い、益々、それらを実現するための様々な用途のアナログ、及びデジタルの 電子回路がプリント基板の形で格納されてきている。また、自動車や航空、ロボ ットや半導体設計装置等、他の産業機器においても動作制御等の手段として、信 頼性が高く、高速・高精度での動作が可能な電子回路基板が数多く搭載されてい る。これらの電子回路基板は一連の機能を実現するために、様々な形でケーブル を介して接続されることにより、所望のスペックが実現されている。

[0003]

このような基板が搭載される機器が使用される環境は、通常はオフィス内であ ったり、家屋内であったりするが、それ以外のも過酷な環境下で使用される場合 もあり、非常に多岐にわたっている。特に使用環境が劣悪である場合には、通常 の方法で使用していたとしても、様々な状態の検出が困難な異常、故障が発生し 、その修復には多大な労力を要することになる。

[0004]

また、通常の使用環境下で使用している場合でも、電子回路の異常、故障は発 生し、その頻度は必ずしも低いとは言えず、検出箇所を特定できないこともしば しば生じていた。さらに、電子回路基板に異常が発生した場合には、安全性やコ ストなどの面から早急な対応が必要でもあった。

[0005]

上述した対応の一例として、複写機やプリンタ等の異常、故障情報の連絡が入った場合、修理担当者が現地に駆けつけて機器に記録されている故障個所情報や 故障履歴の情報等をもとに故障部位の特定を行い、交換する、あるいは修復作業 を行う、などの措置手段を講ずることがある。

[0006]

あるいは、これらの機器がネットワークに接続されており、自動的にこれらの 情報を管理する部署へ、状態の管理や故障情報等を伝送する場合には、これらの 情報をあらかじめ解析した上で、修理担当者により、同様の措置が取られる。

[0007]

しかし、上述のような異常、故障が発生した場合には、通常、機器は使用不可 能となり、ダウンタイムが生じてしまう、というユーザ側にとってのデメリット が発生する。

[0008]

また、メーカ側にとっても、故障部位の特定に手間取ったり、故障部位が必ず しも正確に特定できるとは限らず、故障と考えられる部分を全て交換する等の措 置により、多大なコストが発生したり、あるいは修理そのものに時間がかかって しまう、マンパワー的な対応がおいつかない、といったような状況が発生してい る。従って、ユーザ側/メーカ側双方に取り、多大な損失を被る状況が多発して いるという事実がある。

【0009】

そこで、故障部位を特定したり、発生自体を予測する場合、故障箇所を特定す る精度を上げたり、特定するまでの時間的なロスを削減する、異常、故障状態を もれなく把握する、これらの構成を簡単かつ低コストで実現する、といった方法 について様々な試みがなされている。

[0010]

例えば、非特許文献1では、ターゲットとする配線を流れる電流から発生する 磁場を検出する超小型でかつ独自の形状を有する磁界検出プローブを用いた非接 触方法により、基板の配線を非接触スキャンする方式によって、現状の高密度配 線プリント基板における配線の断線、線幅異常を主に、ICの故障等も含めた基 板で発生する異常を検出する手法を、高速かつ機械的なストレスのない状態で実 現しようとしたものである。

[0011]

また、特許文献1では、各電子基板の電源電流を電源に並列接続した抵抗に流 し、その両端の電位差から夫々の電子基板の電流情報を読み取って通常状態と比 較して故障を判別する、ことで実現しようとしている。

[0012]

【特許文献1】

特開平2000-74998号公報

【非特許文献1】

藤城 久、他2名、"渦電流探傷技術によるプリント配線の欠陥検出 "、[online]、平成14年、金沢大学工学部、[平成14年12月4日検索]、イ ンターネット<URL:http://magmacl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp/magcap-j/research -j/ecta-j.html>

[0013]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、このような回路基板検査装置においては次のような問題がある 。すなわち、非特許文献1で開示される技術では、回路基板上の信号線の状態や 電流から発生する磁界を非接触のまま高精度にセンシングすることは可能である ものの、磁界をセンシングする手段として使用する専用プローブは高価であり、 故障検出コストがかかる。しかも一度に測定できる領域はピンポイントであるた め、回路基板全体にわたって故障を検査するためには多大な時間が必要になる、 あるいは手間がかかるという問題が生ずる。

[0014]

また、特許文献1で開示される技術では、センシング部を回路基板設計時に組 み込むなどして固定的に使用する必要があり、構成の柔軟性に乏しい、という問 題が発生する。

[0015]

【課題を解決するための手段】

本発明はこのような課題を解決するために成されたものである。すなわち、本 発明は、所定の部品や配線が形成されて成る回路基板の動作を検査する回路基板 検査装置において、回路基板の部品実装面と略平行に配置される支持基板と、支 持基板が回路基板と略平行に配置された状態で、支持基板における回路基板の部 品もしくは配線と対応する位置に配置される信号変化検出手段とを備えている。

[0016]

このような本発明では、支持基板における、回路基板の部品もしくは配線と対応する位置に信号変化検出手段が配置されていることから、この信号変化検出手段が配置された支持基板を回路基板と略平行に配置することで部品もしくは配線

に対応して信号変化検出手段が位置合わせされ、回路基板に実装される部品や配 線の検査を容易かつ的確に行うことができるようになる。また、回路基板に予め 信号変化検出手段を組み込む必要がなく、支持基板に信号変化検出手段を配置す るため、検査対象となる回路基板の部品レイアウトに合わせて信号変化検出手段 を配置でき、既存の回路基板への対応も可能となる。

[0017]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図に基づき説明する。図1、図2は、本実施形態 に係る回路基板検査装置を説明する図、図3は、検査を説明する図である。すな わち、本実施形態に係る回路基板検査装置は、所定の部品3や配線が形成されて 成る回路基板1の動作を検査するためのものであり、この回路基板1の部品実装 面と略平行に配置される支持基板4と、支持基板4が回路基板1と略平行に配置 された状態で、支持基板4における回路基板1の部品3もしくは配線と対応する 位置に配置される信号変化検出手段(コイル5やコンデンサ6)とを備えて構成 されている。

[0018]

信号変化検出手段としては、部品3や配線を流れる電流から発生する磁界によって誘導起電力を発生するコイルであったり、電流配線を流れる信号変化によっ て電位情報を生じさせるインピーダンス成分(容量成分やインダクタンス成分、 抵抗成分で構成されるもの)から成る。

[0019]

この回路基板検査装置を実現するには、支持基板4として平面状の絶縁性の板 であるフレキシブル(可撓性)基板を用い、コイル5やコンデンサ6をその上に 形成する。図1(a)では回路基板1上に配置されているコネクタ2の周辺や回 路基板1の外周を包囲するようコイル5が配置されたり、特定の部品3(例えば 、集積回路)の周囲を包囲するようコイル5が配置されている。また、特定のコ ネクタ2に接続される入出力配線群に直交するように容量成分として機能する構 成(例えば、コンデンサ6)が配置されている。

[0020]

フレキシブル基板から成る支持基板4は、適用する回路基板1と縦横略同サイ ズであり、回路基板1とフレキシブル基板とを略平行に重ねた時に、フレキシブ ル基板上に形成されているコイル5やコンデンサ6が、ちょうど所望の箇所へあ てがわれるような位置にくるように配置する。このようにして、配置された各部 からの電気的な信号は信号取り出し部7へと接続され、そこから外部へ取り出す ようにする。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

コイル5やコンデンサ6から成る信号変化検出手段が複数ある場合には、各信 号変化検出手段の片方の端子を支持基板4の端部で共通接続してもよい。また、 共通で接続された端子を支持基板4の外部で接地するようにしてもよい。さらに 、各信号変化検出手段の配線は、近接させた状態で略平行にして支持基板4を引 き回すようにする。このような配線によってコイル5やコンデンサ6による信号 変化を精度良く捉えることが可能となる。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

また、支持基板4における信号変化検出手段を配置しない部分で、支持基板4 を回路基板1に近接させる際に干渉してしまう部品がある場合、その部品と対応 する支持基板4の位置に孔(図示せず)を設けておき、部品と支持基板4とが接 触しないようにすることもできる。

[0023]

図1(b)は回路基板へ適用する他の形態を示している。回路基板1単体では なく、複数の回路基板1が接続されてなる回路基板群へ適用する場合、各回路基 板1間を接続するケーブルも含め、図に示したように同サイズのフレキシブル基 板から成る支持基板4を回路基板群と略平行に近接して固定し、上述した手法に より各部の状態を検出する。

[0024]

また、図1(c)は、形成されるコイルの他の形状を示している。これは支持 基板4に直に形成する場合でも同じであるが、回路基板1を駆動しているときに 発生する磁界のうち、回路基板1と平行に生じている部分をセンシングする場合 に用いるものである。したがって、コイル5は支持基板4の表裏に形成される信 号層10、11にかかる厚さ方向の二次元を利用して形成される。

[0025]

図1(d)は、支持基板4上に形成されるコンデンサ6の構成例である。支持 基板4の信号層10、11両面に、所望の面積の電極を形成してコンデンサ6を 構成し、各電極に接続された信号線を信号取り出し部7まで接続することにより 、クロストークの結果、電極間で発生する電位情報を抽出する。図1(e)は、 図1(d)を実際に配線群上へあてがった場合の等価回路である。

[0026]

図2(a)は例えば4巻きコイル5を2個と図示したサイズのコンデンサ6を 支持基板4へ構成した状態を示す図である。支持基板4は、厚さ方向に対して、 中央部に絶縁層を設け、その両面に信号層を設ける構成とし、外部との電気的接 触を避ける場合には絶縁樹脂等でコーティングする。

[0027]

コイル5は両信号層に2巻きずつ同じ方向に回転するようにして形成し、両層 の間をスルーホール12で接続する。したがって、図2(a)では2巻きコイル 配線が形成されている層の反対側の層に形成されている2巻きコイル(図の一点 斜線)へ実線で示されている2巻きコイルからスルーホール12を介して接続さ れる。

[0028]

そして、コイルが2回転したところで再びスルーホール12を介して表層へと 導かれる。コイル5の両端に接続された配線15は、二本対になるようにして並 行して信号取り出し部7近傍まで配線され、片方の配線が再びスルーホール12 を介して別の層へ移り、そこで他の信号線対の片方の配線と接続され、それが信 号取り出し部7を介して抽出される。もう片方の配線はそれぞれが独立して信号 取り出し部7から抽出される。

[0029]

コンデンサ6も同様に、支持基板4の表裏に形成された電極対に各々配線14 が接続され、一方の配線がスルーホール12を介して反対の層へ導かれている。 そして、この配線14を平行させて配線対16とし、信号取り出し部7まで引き

回されている。

[0030]

図2(b)は、図2(a)の信号取り出し部7を介して取り出された信号を解 析し、回路基板に異常が発生しているかどうかを診断するプロセスを示すブロッ ク図である。信号取り出し部7より送られてきた信号は、信号選択部21におい て任意の信号が選択される。一方、記憶部22には、信号取り出し部7より取り 出される各信号の正常状態を測定したデータが格納されており、信号選択部21 において選択した信号の状態を正常状態と比較する比較照合部23でこれらの信 号を比較することにより、その差異を抽出する。

[0031]

診断部24は、比較照合部23で抽出された差異が正常状態と比較して同等の 範囲にあるかどうかを判断する部分であり、回路基板や検査対象の部位が正常に 動作しているかどうかを診断する。なお、この信号選択部21、記憶部22、信 号照合部23および診断部24は、全てが支持基板4に設けられていても、全て が支持基板4の外部に設けられていても、また一部が支持基板4に設けられ、残 りが支持基板4の外部に設けられていてもよい。

[0032]

図3は、本実施形態の回路基板検査装置を用いた磁界情報の変化を説明する図 で、誘導起電力を縦軸、時間を横軸にして示したものである。図3(a)は正常 な状態で測定した結果を示したものであり、これが回路基板の一部に異常が発生 することにより、図3(b)に示すように振幅が小さくなる結果が得られる。

[0033]

したがって、所定の回路基板に故障が発生しているかどうかを診断することが 可能となり、しかも回路基板の設計によらず、後から本実施形態の回路基板検査 装置を付加することで対応でき、非常に柔軟性のある検出装置としての提供が可 能となる。

[0034]

図4~図9は本実施形態の具体的な実施例を説明する図である。先ず、図4~ 図6を用いて第1の実施例について説明する。図4に示された各回路基板41、 42、43に、先に説明した本実施形態の回路基板検査装置を近接して取り付け る。各回路基板検査装置には、回路構成に照らし合わせて符号411、412、 413、414、415、416、417の周囲を包囲するようにコイルを形成 する。

[0035]

図5~図6は、夫々、基板41上の回路部412および基板42上の回路部4 14について、本実施形態の回路基板検査装置を近接した時にこれらの回路を包 囲するようにして形成されたコイルによってセンシングされる磁場によって発生 する誘導起電力波形を示したものである。

[0036]

図5(a)、図6(a)は正常状態における波形であり、図5(b)、図6(b)は、断線異常45が発生した場合の波形を示している。各基板が正常に動作 している場合には、基板41上の発信器44が発生するクロックによって動作す る基板42上の回路部414について、これを包囲するようにして形成された支 持基板上のコイルでセンシングした磁場によって発生する誘導起電力の時間的な 変化は、図5(a)に示すように、周期T11の中に±V11、±V12、±V 13の3つのピークを有する波形として観測される。

[0037]

同様に基板41上の回路部412もまた、発信器44からのクロック信号によって動作し、これを包囲するようにして形成された支持基板上のコイルでセンシングした磁場によって発生する誘導起電力の変化は、図6(a)に示すように、 周期T14の中に±V14、±V15の2つのピークを有する波形として観測される。

[0038]

今、図に示したようにして接続されている各基板間で、基板41上で駆動する 発信器より基板41から基板42に送られているクロック用のケーブルラインが 基板42上で断線する異常45が発生したとする。

[0039]

このとき、基板41上の回路部412は正常に動作しているため、コイルでセ

ンシングする回路および周辺部の磁場には特に変化は観測されず、したがってコ イルの両端に発生する誘導起電力波形もまた、図6(b)に示すように特に変化 は見られない。

[0040]

しかし、基板42上の回路部414は断線のため、回路動作に必要なクロック 信号が入力されず、回路が正常に動作しない。したがって、回路部414を包囲 するようにして形成されたコイルから得られる誘導起電力波形は大きく変化し、 図5(b)に示すように3つのピークを示す振幅が正常状態と比較して大きく下 回る結果が得られる。

[0041]

特に図示はしないが、他の回路部は特に影響がないため、回路部412を包囲 するように形成されたコイルから得られる誘導起電力波形同様、正常状態と変化 はない。これらの結果より、異常が発生しているのは基板42であると診断する ことが可能となる。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 & 2 \end{bmatrix}$

次に、別の故障状態を検出する実施例として、図7~図9に沿って第2の実施 例について述べる。図7は、第2の実施例を説明するための回路構成概略を示す 図であり、各回路基板71、72および73とその接続等の構成および、各回路 基板へ近接するフレキシブル基板の構成については、第1の実施例と同様である 。ただし、各回路部の詳細な回路構成は異なっているものがあるものとする。

[0043]

図8~図9は、それぞれ基板72上の回路部714および基板73上の回路部 716について、フレキシブル基板を近接した時にこれらの回路を包囲するよう にして形成されたコイルによってセンシングされる磁場によって発生する誘導起 電力波形を示したものである。

[0044]

図8(a)、図9(a)は正常状態における波形であり、図8(b)、図9(b)は、回路部716内の領域80が動作しなくなる現象が発生した場合の波形 を示している。

[0045]

各基板が正常に動作している場合には、基板71上の発信器74が発生するクロックによって動作する基板73上の回路部716について、これを包囲するようにして形成されたフレキシブル基板上のコイルでセンシングした磁場によって 発生する誘導起電力の時間的な変化は、図8(a)に示すように、周期T21の中に±V21、±V22の2つのピークを有する波形として観測される。

[0046]

同様に基板72上の回路部714もまた、発信器74からのクロック信号によって動作し、これを包囲するようにして形成されたフレキシブル基板上のコイル でセンシングした磁場によって発生する誘導起電力の変化は、図9(a)に示す ように、周期T24の中に±V24、±V25の2つのピークを有する波形とし て観測される。

[0047]

今、図7に示したようにして接続されている各基板間で、基板71上で駆動す る発信器より基板71から基板72および基板73に送られているクロックを基 準として駆動する回路部716内の領域80が動作しなくなる現象が発生したと する。

[0048]

このとき、基板72上の回路部714は正常に動作しているため、コイルでセ ンシングする回路及び周辺部の磁場には特に変化は観測されず、したがってコイ ルの両端に発生する誘導起電力波形もまた、図9(b)に示すように特に変化は 見られない。

[0049]

しかし、基板73上の回路部716は回路部内で発生した異常のため、正常に 回路が動作しておらず、正常状態にように磁場の発生原因である電流変動もまた 正常ではない。

[0050]

したがって、回路部716を包囲するようにして形成されたコイルから得られ る誘導起電力波形は大きく変化し、図8(b)に示すように2つのピークを示す

振幅が正常状態と比較して大きく下回る結果が得られる。

[0051]

特に図示はしないが、他の回路部は特に影響がないため、回路部714を包囲 するように形成されたコイルから得られる誘導起電力波形同様、正常状態と変化 はない。これらの結果より、異常が発生しているのは基板73であると診断する ことが可能となる。

[0052]

なお、本実施例では、磁場をセンシングするコイルの設置位置を回路基板にフ レキシブル基板を近接した際に回路部周囲にくるように配置したが、これはもっ とも必要な情報をセンシングできる位置に設置することを意味している。

[0053]

また、本実施例ではコイルを形成するものをフレキシブル基板とし、回路基板 、ケーブル等に固定することを示唆したが、支持基板4となるフレキシブル基板 を箱体に組立自在にしておき、検査対象となる回路基板やケーブルを箱体に組み 立てた内部に収納して検査を行うようにしてもよい。

[0054]

図10は、回路基板検査装置の他の例を説明する模式斜視図である。この回路 基板検査装置は、回路基板1の部品実装面と略平行に配置される支持基板として 、回路基板1の表側に配置される表側支持基板4aと、回路基板1の裏側に配置 される裏側支持基板4bとを備えるものである。

[0055]

すなわち、この回路基板検査装置は、検査対象となる回路基板1の表裏両面に 部品3やコネクタ2と接続される配線が設けられているものに対応するため、表 側支持基板4aには回路基板1の表側に配置される部品等の位置に対応して信号 変化検出手段が配置され、裏側支持基板4bには回路基板1の裏側に配置される 部品等の位置に対応して信号変化検出手段が配置されている。なお、ここでは信 号変化検出手段としてコイル5を用いる例を中心とするが、上記説明したコンデ ンサ6を用いるようにしてもよい。

[0056]

表側支持基板4 a および裏側支持基板4 b はフレキシブル(可撓性)基板を用 い、また、信号変化検出手段であるコイル5は、表側支持基板4 a および裏側支 持基板4 b の各々について回路基板1と略平行に配置した際、部品3等の周辺を 包囲するような位置に設けられる。

[0057]

۲

例えば、表側支持基板4aには回路基板1の表側に実装される部品3や配線と 対応する位置にコイル5が設けられ、裏側支持基板4bには回路基板1の裏側に 実装される部品3'や配線と対応する位置にコイル5'が設けられる。

[0058]

また、回路基板1に表側から配置する表側支持基板4aは、コイル5が回路基 板1の表面に密着するよう部品3が搭載されている部分と対応する場所に、部品 3と同サイズ以上の大きさの穴hを設けておく。コイル5はこの穴hを囲む状態 で形成される。なお、同様な穴hは必要に応じて裏側支持基板4bに設けてもよ い。

[0059]

このように、コイル5は、表側支持基板4aおよび裏側支持基板4bのうち、 検査対象となる部品3や配線が配置されている側(回路基板1の電源層もしくは 接地層を基準とした配置)に対応する方のみに設けられる。

[0060]

ここで、表側支持基板4 a および裏側支持基板4 b は別個に設けてもよいが、 図11の模式断面図に示すように、表側支持基板4 a および裏側支持基板4 b が 一体的に形成され、途中で折り曲げるようにして回路基板1の表裏に密着させる ようにしてもよい。表側支持基板4 a および裏側支持基板4 b が一体的に形成さ れている場合、信号変化検出手段であるコイルを表側支持基板4 a と裏側支持基 板4 b との各々にまたがって形成してもよい。

[0061]

図12は、回路基板の表裏に支持基板を配置する場合の具体例を説明する模式 図である。信号変化検出手段であるコイルは、図12(a)の一点鎖線で示した 包囲領域A、B、Cを囲むように図中二重線で示す位置に作製される。すなわち

、回路基板1の表面に装着する表側支持基板4aにはコイルA2、B2、C2を 作製し、回路基板1の裏面に装着する裏側支持基板4bにはコイルをA1、B1 を作製する。

[0062]

なお、包囲領域Bについては、部品3が回路基板1の表面側に表面実装品とし て搭載されているものとし、これを観測するコイルも表面から配置するB2のみ を表側支持基板4aに作り込むのみとする。

【0063】

ここで、回路基板1が正常状態から故障状態(1)、故障状態(2)になった 場合の動作を説明する。なお、図12(a)に示すコネクタ2に接続されている 配線のうち、実線で示したものは回路基板1の表面を、点線で示したものは回路 基板1の裏面を通っているものとする。

[0064]

図12(b)に示す故障状態(1)では、包囲領域Aを通る配線群のうち、表面を通る配線の1本(配線A01)が断線した状態を示している。一方、図12 (b)に示す故障状態(2)は同様の包囲領域のうち、裏面を通る配線の一本(A02)が断線した状態を示している。

[0065]

図13は、正常状態および各故障状態のコイルの出力変化を示す模式図である 。図13(a)は、図12に示す正常状態におけるコイルA1およびコイルA2 の出力信号すなわち誘導起電力を示している。同様に、図13(b)は、図12 に示す故障状態(1)におけるコイルA1およびコイルA2の出力信号すなわち 誘導起電力を示している。同様に、図13(c)は、図12に示す故障状態(2))におけるコイルA1およびコイルA2の出力信号すなわち誘導起電力を示して いる。

【0066】

先ず、正常状態では、コイルA1の出力波形はT1の周期で、±Vl1、±Vml、 ±Vh1の3種類のピークが図示する状態で観測されている。一方でコイルA2の 波形はT2の周期で、±Vl2、±Vh2の2種類のピークが図示する状態で観測され

ている。

[0067]

このような正常状態から包囲領域Aにおける回路基板表面側の配線A01の断線故障が発生すると故障状態(1)となり、図13(b)に示すように、回路基板表面側に配置した表側支持基板4aのコイルA2の出力波形に変化が生じる。 つまり、連続する3つのピーク波形の後に生じていた±Vh2の振幅を有する4番目のピーク波形の出現している時間が長くなっている。

[0068]

一方、回路基板裏面側に配置した裏側支持基板4bのコイルA1の出力波形は、図13(a)、(b)に示すように、正常状態から特に変化は観測されない。

[0069]

次に、包囲領域Aにおける回路基板裏面側の配線A02の断線故障が発生する と故障状態(2)となり、図13(c)に示すように、回路基板裏面側に配置し た裏側支持基板4bのコイルA1の出力波形に変化が生じる。つまり、1周期の 中に出現する5つのピーク波形のうち、2番目のピークの振幅が±Vm1から±Vhh 1へと増大する一方で、正常状態では観測されていた±V11の振幅を有する5番目 のピーク波形が消失していることが確認される。

[0070]

しかし、回路基板表面側に配置した表側支持基板4 a のコイルA 2 の出力波形 は、図13(a)、(c)に示すように、正常状態から特に変化は観測されない。

[0071]

上述のようにして、一つの包囲領域に対して、回路基板1の表面と裏面の双方 から配置されたコイルによってセンシングされた信号を、信号処理フローと絡め て、その領域において本来入出力されているべき信号が入出力されていない状況 を表面と裏面に配置したコイルの双方から読み取ることでその領域およびその領 域を有する回路基板1が正常であるかどうかを判断することができる。

 $\{0072\}$

なお、上記の例では、コイルから得られる出力波形の振幅が全てプラス側とマ

イナス側で対称であるものとした例を示したが、これは包囲領域における回路構成によって非対称である場合もあり、その場合にも本発明の回路基板検査装置は 適用可能である。また、上記説明した一つの包囲領域に表面と裏面の双方からコ イルを適用する方法は、包囲領域でセンシングしたい信号の強度や回路構成に依 存する部分があり、場合によっては表面または裏面の片側にコイルを配置するの みで目的を達成することも可能となる。

[0073]

また、センシングした信号を用いて正常状態との波形比較を行い、故障状態を 判定する回路は、支持基板4、4a、4bに内蔵されていても、また外部に設け られていてもよい。

[0074]

【発明の効果】

以上で説明したように、本発明によれば、簡単な構成でかつ低コストで回路基 板の故障を特定することが可能となる。また、本発明によれば、既存の回路基板 に対してもその回路基板に実装される部品や配線の位置に対応して支持基板に信 号変化検出手段を設けることで、回路基板の部品レイアウトに合わせた構成を容 易に実現でき、所望の部品等の検査を的確に行うことが可能となる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本実施形態を説明する図(その1)である。
- 【図2】 本実施形態を説明する図(その2)である。
- 【図3】 検査を説明する図である。
- 【図4】 第1の実施例を説明する図である。
- 【図5】 第1の実施例における検査を説明する図(その1)である。
- 【図6】 第1の実施例における検査を説明する図(その2)である。
- 【図7】 第2の実施例を説明する図である。
- 【図8】 第2の実施例における検査を説明する図(その1)である。
- 【図9】 第2の実施例における検査を説明する図(その2)である。
- 【図10】 回路基板検査装置の他の例を説明する模式斜視図である。
- 【図11】 表側支持基板および裏側支持基板を一体的に形成した例を説明

する模式断面図である。

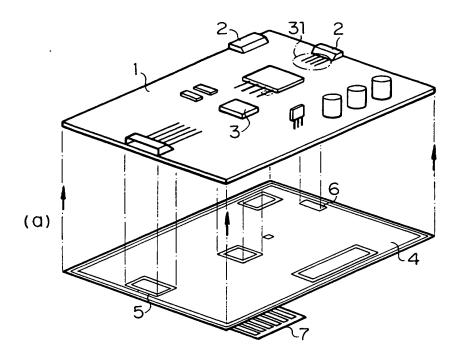
【図12】 回路基板の表裏に支持基板を配置する場合の具体例を説明する 模式図である。

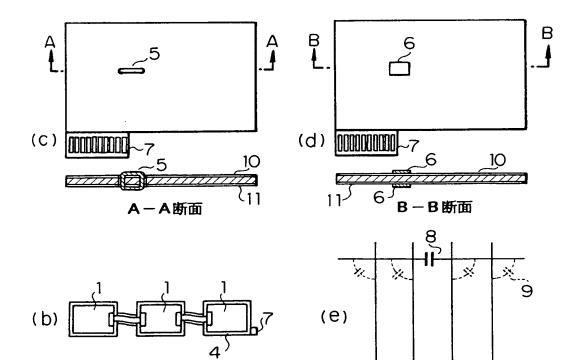
【図13】 正常状態および各故障状態のコイルの出力変化を示す模式図で ある。

【符号の説明】

1…回路基板、2…コネクタ、3…部品、4…支持基板、4 a…表側支持基板 、4 b…裏側支持基板、5…コイル、6…コンデンサ、7…信号取り出し部、h …穴 【書類名】図面

【図1】



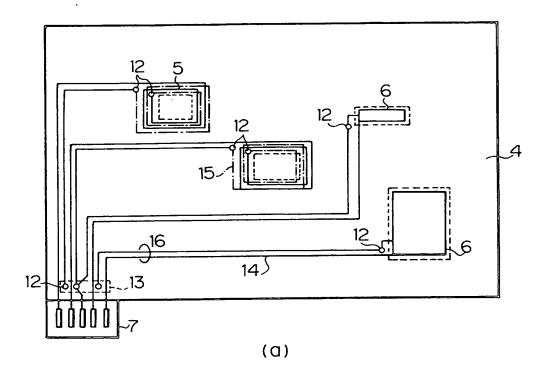


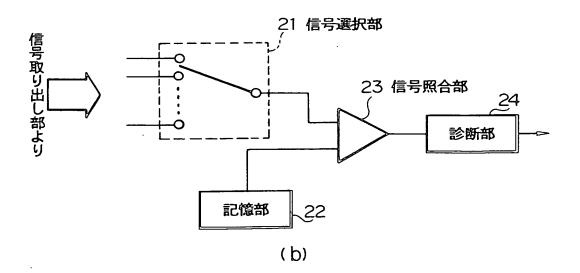
出証特2003-3110189

3ı

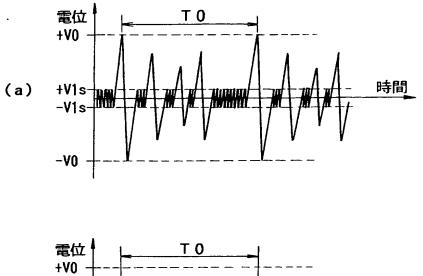
【図2】

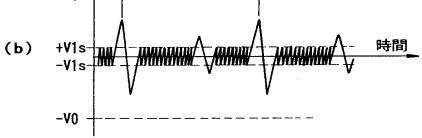
Ο



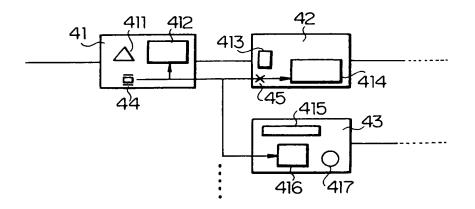




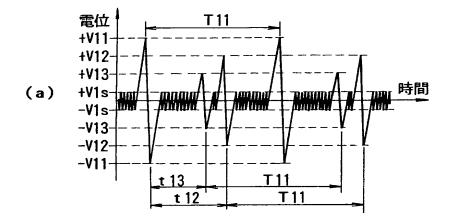


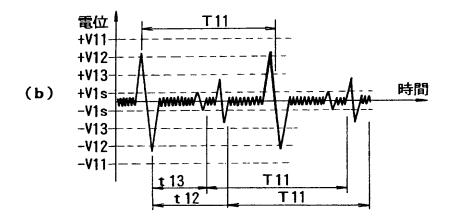




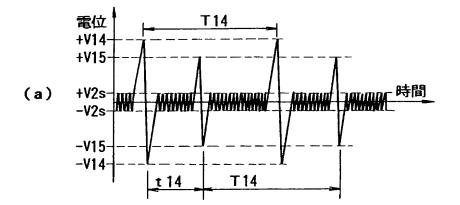


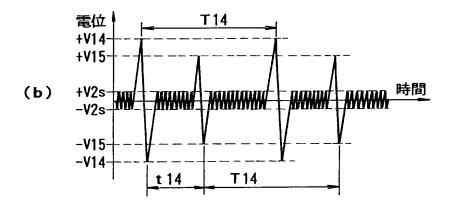
【図5】



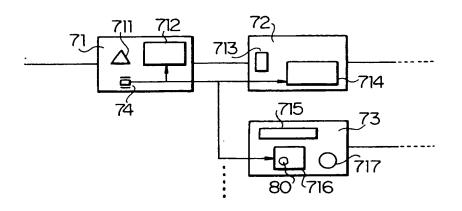


【図6】



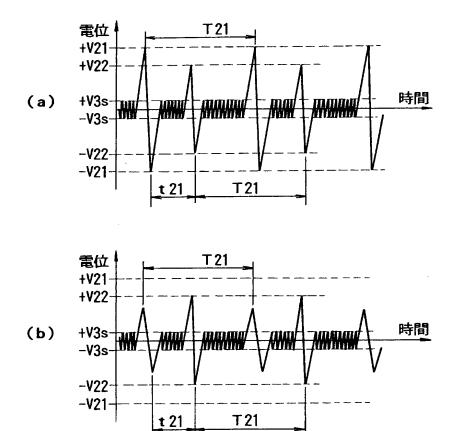


【図7】



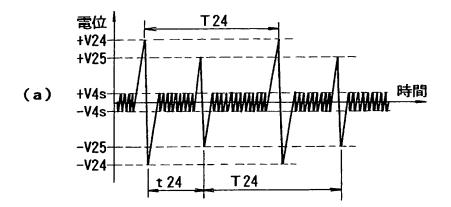
【図8】

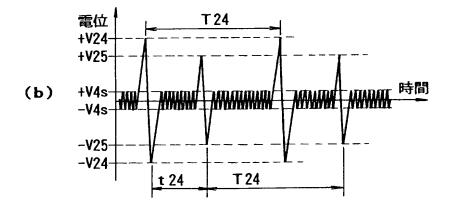
۰.



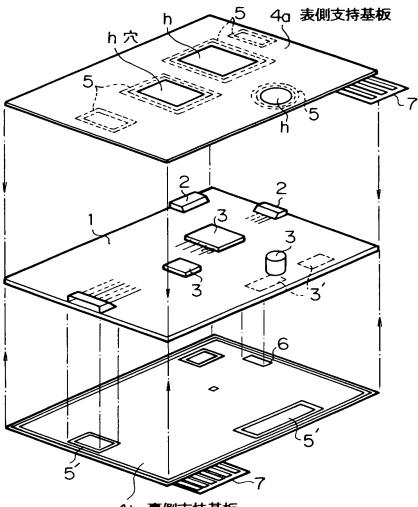
ページ: 6/

【図9】





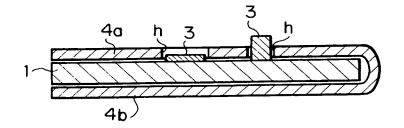
【図10】



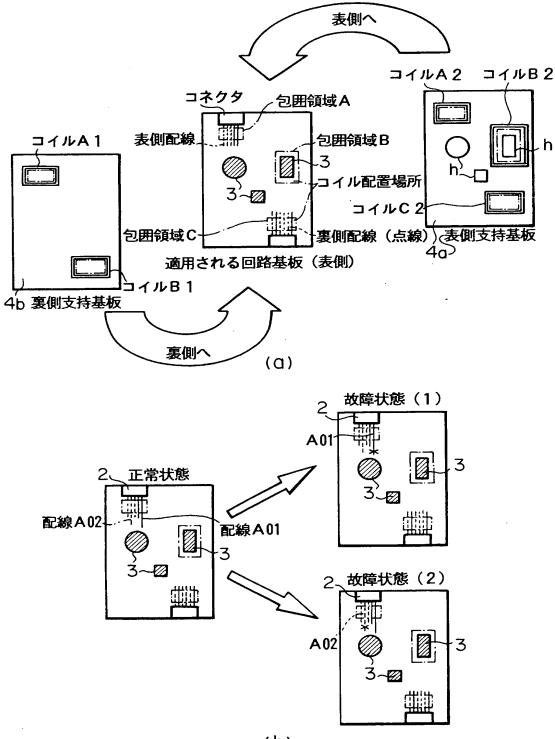
4b 裏側支持基板

【図11】

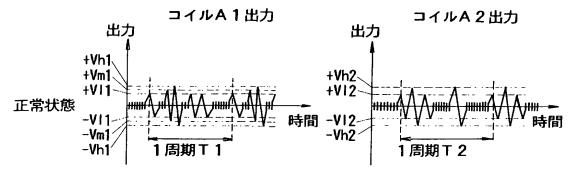
-



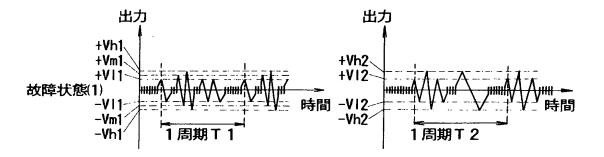
【図12】



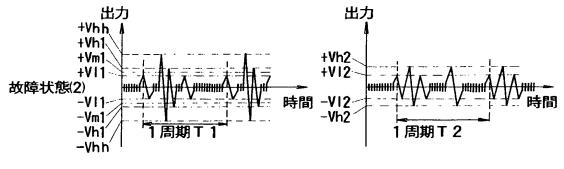
【図13】



(a)



(b)



(c)

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 回路基板の検査を行う装置の簡素化および的確な検査を行うことがで きる構成を提供すること。

【解決手段】 本発明は、所定の部品3や配線が形成されて成る回路基板1の動作を検査する回路基板検査装置において、回路基板1の部品実装面と略平行に配置される支持基板4と、支持基板4が回路基板1と略平行に配置された状態で、 支持基板4における回路基板1の部品3もしくは配線と対応する位置に配置されるコイル5やコンデンサ6から成る信号変化検出手段とを備えている。

【選択図】 図1

認定·付加情報

特許出願の番号	特願2003-17769	7
受付番号	$5\ 0\ 3\ 0\ 1\ 0\ 3\ 9\ 8\ 7\ 2$	
書類名	特許願	
担当官	第一担当上席	0090
作成日	平成15年 6月26日	

<認定情報·付加情報>

【特許出願人】

ェン
1

次頁無

特願2003-177697

出願人履歴情報

識別番号

:.

۰.

[000005496]

1. 変更年月日	1996年 5月29日
[変更理由]	住所変更
住 所	東京都港区赤坂二丁目17番22号
氏名	富士ゼロックス株式会社

-